

# SanDisk et Toshiba lancent des composants flash 3D de haute densité

Le couple **SanDisk - Toshiba** présente aujourd'hui de nouveaux composants flash NAND utilisant une structure 3D, afin d'atteindre une plus grande capacité de stockage. Ces puces proposent en effet 48 couches et une capacité de 256 Gb, soit **32 Go**.

Samsung, qui livre déjà des puces 32 couches de 128 Gb, est donc battu à plate couture. Reste que, comme pour son concurrent coréen, le couple japonais mise ici sur la technologie **TLC**, qui permet de stocker **3 bits par cellule** (et non 2 avec le MLC et 1 avec le TLC). La durée de vie de ces composants sera donc moindre en cas de fréquentes écritures.

De plus, il faudra attendre **2016** pour que ces composants soient effectivement disponibles. Pendant ce temps, Samsung a donc le champ libre... et l'opportunité de faire lui aussi évoluer son offre vers plus de densité.

## **Des SSD plus gros et moins chers**

Ces composants de haute capacité permettront non seulement de créer des disques flash (SSD et autres) de plus grande taille, mais également **d'en abaisser les coûts**. Il est aujourd'hui possible de trouver des SSD de 240/250 Go pour moins de 100 euros TTC. Ces tarifs devraient donc encore chuter.

Reste que SanDisk comme Samsung devront compter avec l'arrivée de la mémoire **3D XPoint**, mise au point par Intel et Micron. Cette dernière promet d'allier la vitesse de la DRAM à la non-volatilité des puces flash NAND. Voir à ce propos notre article « [Avec 3D XPoint, Intel et Micron révolutionnent le monde du stockage flash](#) ».

### **À lire aussi :**

[Stockage flash : Micron se lance dans le 16 nm](#)

[SanDisk multiplie les offres de stockage flash portables](#)

[128 Go de stockage à haute vitesse dans les smartphones ?](#)